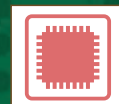
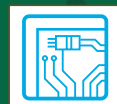


BGA/CSP パッケージ時代の ボード設計術

**高密度プリント基板の品質を上げて
コストを抑えるくふう**



デバイスの記事



ボードの記事

本特集では、大規模LSIでよく採用されている多ピンBGA/CSPパッケージの実装技術を取り上げます。ピン数が増えることにより、プリント基板の層数が増加し、高密度配線が要求されるようになります。品質を保ちながらコストを抑えるためには、回路設計とプリント基板のパターン設計の両面でくふうが必要になります。

第1章 大規模LSI実装の現状と課題

——回路設計をくふうすれば高品質のプリント基板ができる
坂田 秀幸

第2章 回路設計者のためのプリント基板Q&A

——BGA/CSP実装で起こる疑問を解消する
渡辺 一弘

第3章 非貫通ビア基板の活用技術

——1,508ピン・フルグリッドから全ピン引き出しを効率的に実現
岩佐 三郎, 辻 寿一, 水尾 学

第4章 多ピンBGAの省スペース実装事例

——PC Cardの中に大規模FPGAを入れる
佐藤 保